

香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该内容而引致的任何损失承担任何责任。



HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED

华虹半导体有限公司

(于香港注册成立之有限公司)

(股份代号：01347)

新闻稿

二零二五年第三季度业绩公布

所有货币以美元列帐，除非特别指明。

本合并财务报告系依香港财务报告准则编制。

中国香港 — 2025 年 11 月 6 日 — 全球领先的特色工艺纯晶圆代工厂华虹半导体有限公司（香港联交所股票代码：01347；上交所科创板证券代码：688347）（“本公司”）于今日公布截至二零二五年九月三十日止三个月的综合经营业绩。

二零二五年第三季度主要财务指标（未经审核）

- 销售收入创历史新高，达 6.352 亿美元，同比增长 20.7%，环比增长 12.2%。
- 毛利率 13.5%，同比上升 1.3 个百分点，环比上升 2.6 个百分点。
- 母公司拥有人应占利润 2,570 万美元，同比下降 42.6%，环比上升 223.5%。

二零二五年第四季度指引

- 我们预计销售收入约在 6.5 亿美元至 6.6 亿美元之间。
- 我们预计毛利率约在 12%至 14%之间。

总裁致辞

公司董事会主席兼总裁白鹏博士对二零二五年第三季度业绩评论道：

“华虹半导体二零二五年第三季度销售收入创历史新高，达 6.352 亿美元，符合指引预期；毛利率为 13.5%，优于指引。在全球半导体需求回暖和公司精益管理的双重驱动下，公司产能利用率持续高位运行，销售收入和毛利率均实现同比及环比增长。公司在工艺研发、市场销售、生产运营等核心竞争力的提升和降本增效的成果已逐步展现，整体盈利能力向好，为长期可持续发展奠定坚实基础。”

白总继续表示：“华虹半导体在特色工艺领域拥有丰富的积累储备和优秀的管理经验。面对快速变化的国内外半导体市场格局，公司需要在技术节点、工艺能力、产能建设等诸多核心维度不断迈进。正在顺利推进过程中的收购事项将进一步提升公司产能规模并丰富工艺平台覆盖，同时与无锡 12 英寸生产线形成协同效应，强化公司的盈利能力。此外，公司也在积极布局产能建设规划，聚焦技术突破和生态构建，在全球产业变局中持续提升核心竞争力。”

电话会议公告

日期 2025 年 11 月 6 日，星期四

时间： 17:00 香港/上海时间

04:00 美国东部时间

发言人： 白鹏，董事会主席兼总裁

王鼎，执行副总裁兼首席财务官

广播： 会议将在 https://www.huahonggrace.com/c/ir_calendar.php 或

<https://edge.media-server.com/mmc/p/e4idyvb2> 作在线直播

(请提前注册登记)

电话直拨： 请在会议前使用以下链接先进行注册。注册后，您将收到确认邮件获得拨入号码及 PIN (个人身份识别码)。

<https://register-conf.media-server.com/register/BI0669e89919e0410ebaab072b3eb6b049>

重要提示：在会议开始前，您需要使用确认邮件中提供的 PIN (个人身份识别码) 才能进入会议。请在注册后，注意查收并保存确认邮件。出于安全原因，请不要与任何人共享您的 PIN (个人身份识别码)。

网上回放： 直播约 2 小时后，您可在 12 个月内在以下网页重复收听会议。

https://www.huahonggrace.com/c/ir_calendar.php

关于华虹半导体

华虹半导体有限公司 (A 股简称: 华虹公司, 688347; 港股简称: 华虹半导体, 01347) (“本公司”) 是全球领先的特色工艺纯晶圆代工企业, 秉持 “8 英寸 + 12 英寸”、先进 “特色 IC + Power Discrete” 的发展战略, 为客户提供多元化的晶圆代工及配套服务。本公司专注于嵌入式/独立式非易失性存储器、功率器件、模拟与电源管理和逻辑与射频等特色工艺技术的持续创新, 有力支持新能源汽车、绿色能源、物联网等新兴领域应用, 其卓越的质量管理体系亦满足汽车电子芯片生产的严苛要求。本公司是华虹集团的一员, 而华虹集团是中国拥有 “8 英寸 + 12 英寸” 先进集成电路制造主流工艺技术的产业集团。

本公司在上海金桥和张江建有三座 8 英寸晶圆厂, 另在无锡高新技术产业开发区内建有两座全球领先的 12 英寸特色工艺晶圆厂, 其中之一是全球第一条 12 英寸功率器件代工生产线。

如欲取得更多公司相关资料, 请浏览: www.huahonggrace.com。

经营业绩概要
(以千美元计, 每股盈利和营运数据除外)

	二零二五年 第三季度 (未经审核)	二零二四年 第三季度 (未经审核)	二零二五年 第二季度 (未经审核)	同比	环比
销售收入	635,180	526,306	566,065	20.7 %	12.2 %
毛利	85,854	64,007	61,611	34.1 %	39.3 %
毛利率	13.5 %	12.2 %	10.9 %	1.3	2.6
经营开支	(100,433)	(81,430)	(97,917)	23.3 %	2.6 %
其他收入净额	17,752	51,797	10,602	(65.7)%	67.4 %
税前溢利/(损失)	3,173	34,374	(25,704)	(90.8)%	(112.3)%
所得税开支	(10,363)	(11,461)	(7,097)	(9.6)%	46.0 %
期内(损失)/溢利	(7,190)	22,913	(32,801)	(131.4)%	(78.1)%
净利润率	(1.1)%	4.4 %	(5.8)%	(5.5)	4.7
以下各方应占:					
母公司拥有人	25,725	44,816	7,952	(42.6)%	223.5 %
非控股权益	(32,915)	(21,903)	(40,753)	50.3 %	(19.2)%
持有人应占每股盈利					
基本	0.015	0.026	0.005	(42.3)%	200.0 %
摊薄	0.015	0.026	0.005	(42.3)%	200.0 %
付运晶圆(折合 8 吋千片)	1,400	1,200	1,305	16.7 %	7.3 %
产能利用率 ¹	109.5 %	105.3 %	108.3 %	4.2	1.2
净资产收益率 ²	1.6 %	2.8 %	0.4 %	(1.2)	1.2

二零二五年第三季度

- 销售收入创历史新高, 达 6.352 亿美元, 同比增长 20.7%, 环比增长 12.2%, 主要得益于付运晶圆数量上升及平均销售价格上涨。
- 毛利率 13.5%, 同比上升 1.3 个百分点, 主要得益于产能利用率及平均销售价格提升, 部分被折旧成本上升所抵消; 环比上升 2.6 个百分点, 主要得益于平均销售价格上涨。
- 经营开支 1.004 亿美元, 同比上升 23.3%, 主要由于研发工程片开支及折旧开支上升; 环比上升 2.6%。
- 其他收入净额 1,780 万美元, 同比下降 65.7%, 主要由于外币汇兑收益及利息收入下降, 部分被财务费用下降所抵消; 环比上升 67.4%, 主要由于本季度为外币汇兑收益, 上季度为外币汇兑损失。
- 所得税开支 1,040 万美元, 同比下降 9.6%, 主要由于应课税利润下降。
- 期内损失 720 万美元, 上年同期为溢利 2,290 万美元, 上季度为损失 3,280 万美元。
- 母公司拥有人应占利润 2,570 万美元, 同比下降 42.6%, 环比上升 223.5%。
- 基本每股盈利 0.015 美元, 同比下降 42.3%, 环比上升 200.0%。
- 净资产收益率(年化) 1.6%, 同比下降 1.2 个百分点, 环比上升 1.2 个百分点。

¹产能利用率按平均月约当产量除以总估计月产能计算。

²母公司拥有人应占利润 / 加权平均母公司拥有人应占净资产。

销售收入分析

按类别划分的 销售收入	二零二五年 第三季度 千美元 (未经审核)	二零二五年 第三季度 % (未经审核)	二零二四年 第三季度 千美元 (未经审核)	二零二四年 第三季度 % (未经审核)	同比 千美元	同比 %
晶圆	610,810	96.2 %	497,847	94.6 %	112,963	22.7 %
其他	24,370	3.8 %	28,459	5.4 %	(4,089)	(14.4)%
销售收入总额	635,180	100.0 %	526,306	100.0 %	108,874	20.7 %

■ 本季度 96.2%的销售收入来源于半导体晶圆的直接销售。

销售收入分析

按晶圆尺寸划分的 销售收入	二零二五年 第三季度 千美元 (未经审核)	二零二五年 第三季度 % (未经审核)	二零二四年 第三季度 千美元 (未经审核)	二零二四年 第三季度 % (未经审核)	同比 千美元	同比 %
8 吋晶圆	258,805	40.7 %	263,139	50.0 %	(4,334)	(1.6)%
12 吋晶圆	376,375	59.3 %	263,167	50.0 %	113,208	43.0 %
销售收入总额	635,180	100.0 %	526,306	100.0 %	108,874	20.7 %

■ 本季度来自于 8 吋晶圆和 12 吋晶圆的销售收入分别为 2.588 亿美元及 3.764 亿美元。

销售收入分析

按地域划分的 销售收入	二零二五年 第三季度 千美元 (未经审核)	二零二五年 第三季度 % (未经审核)	二零二四年 第三季度 千美元 (未经审核)	二零二四年 第三季度 % (未经审核)	同比 千美元	同比 %
中国 ³	522,621	82.3 %	434,532	82.5 %	88,089	20.3 %
北美 ⁴	63,832	10.0 %	46,709	8.9 %	17,123	36.7 %
亚洲其他 ⁵	30,302	4.8 %	28,707	5.5 %	1,595	5.6 %
欧洲	18,425	2.9 %	16,358	3.1 %	2,067	12.6 %
销售收入总额	635,180	100.0 %	526,306	100.0 %	108,874	20.7 %

- 本季度来自于中国的销售收入 5.226 亿美元，占销售收入总额的 82.3%，同比增长 20.3%，主要得益于闪存、其他电源管理及 MCU 产品的需求增加。
- 本季度来自于北美的销售收入 6,380 万美元，同比增长 36.7%，主要得益于其他电源管理及 MCU 产品的需求增加。
- 本季度来自于亚洲其他地区的销售收入 3,030 万美元，同比增长 5.6%。
- 本季度来自于欧洲的销售收入 1,840 万美元，同比增长 12.6%，主要得益于 IGBT 及智能卡芯片产品的需求增加。

³包括中国大陆及中国香港。

⁴ 包括于 2020 年由一家总部位于欧洲的公司所收购的一家主要美国客户。

⁵ 包括中国台湾及日本。

销售收入分析

按技术平台划分的 销售收入	二零二五年 第三季度 千美元 (未经审核)	二零二五年 第三季度 % (未经审核)	二零二四年 第三季度 千美元 (未经审核)	二零二四年 第三季度 % (未经审核)	同比 千美元	同比 %
嵌入式非易失性存储器	159,658	25.1 %	132,598	25.2 %	27,060	20.4 %
独立式非易失性存储器	60,598	9.5 %	29,334	5.6 %	31,264	106.6 %
功率器件	169,036	26.7 %	163,253	31.1 %	5,783	3.5 %
逻辑及射频	81,127	12.8 %	77,010	14.6 %	4,117	5.3 %
模拟与电源管理	164,761	25.9 %	124,111	23.5 %	40,650	32.8 %
销售收入总额	635,180	100.0 %	526,306	100.0 %	108,874	20.7 %

- 本季度嵌入式非易失性存储器销售收入 1.597 亿美元，同比增长 20.4%，主要得益于 MCU 产品的需求增加。
- 本季度独立式非易失性存储器销售收入 6,060 万美元，同比增长 106.6%，主要得益于闪存产品的需求增加。
- 本季度功率器件销售收入 1.690 亿美元，同比增长 3.5%，主要得益于超级结产品需求增加。
- 本季度逻辑及射频销售收入 8,110 万美元，同比增长 5.3%，主要得益于逻辑产品的需求增加。
- 本季度模拟与电源管理销售收入 1.648 亿美元，同比增长 32.8%，主要得益于其他电源管理产品的需求增加。

销售收入分析

按工艺技术节点划分的销售收入	二零二五年 第三季度 千美元 (未经审核)	二零二五年 第三季度 % (未经审核)	二零二四年 第三季度 千美元 (未经审核)	二零二四年 第三季度 % (未经审核)	同比 千美元	同比 %
65nm 及以下	172,197	27.1 %	116,596	22.2 %	55,601	47.7 %
90nm 及 95nm	144,396	22.7 %	98,966	18.8 %	45,430	45.9 %
0.11μm 及 0.13μm	73,231	11.5 %	68,274	13.0 %	4,957	7.3 %
0.15μm 及 0.18μm	36,492	5.7 %	37,894	7.2 %	(1,402)	(3.7)%
0.25μm	3,163	0.5 %	4,155	0.8 %	(992)	(23.9)%
0.35μm 及以上	205,701	32.5 %	200,421	38.0 %	5,280	2.6 %
销售收入总额	635,180	100.0 %	526,306	100.0 %	108,874	20.7 %

- 本季度 65nm 及以下工艺技术节点的销售收入 1.722 亿美元，同比增长 47.7%，主要得益于闪存、逻辑及模拟产品的需求增加。
- 本季度 90nm 及 95nm 工艺技术节点的销售收入 1.444 亿美元，同比增长 45.9%，主要得益于其他电源管理及 MCU 产品的需求增加。
- 本季度 0.11μm 及 0.13μm 工艺技术节点的销售收入 7,320 万美元，同比增长 7.3%，主要得益于 MCU 产品的需求增加。
- 本季度 0.15μm 及 0.18μm 工艺技术节点的销售收入 3,650 万美元，同比下降 3.7%。
- 本季度 0.25μm 工艺技术节点的销售收入 320 万美元，同比下降 23.9%，主要由于功率器件产品的需求下降。
- 本季度 0.35μm 及以上工艺技术节点的销售收入 2.057 亿美元，同比增长 2.6%，主要得益于超级结产品的需求增加。

销售收入分析

按终端市场分布划分的 销售收入	二零二五年 第三季度 千美元 (未经审核)	二零二五年 第三季度 % (未经审核)	二零二四年 第三季度 千美元 (未经审核)	二零二四年 第三季度 % (未经审核)	同比 千美元	同比 %
消费电子	407,544	64.1 %	330,928	62.9 %	76,616	23.2 %
工业及汽车	137,858	21.7 %	123,853	23.5 %	14,005	11.3 %
通信	79,843	12.6 %	65,952	12.5 %	13,891	21.1 %
计算	9,935	1.6 %	5,573	1.1 %	4,362	78.3 %
销售收入总额	635,180	100.0 %	526,306	100.0 %	108,874	20.7 %

- 本季度消费电子作为我们的第一大终端市场，贡献销售收入 4.075 亿美元，占销售收入总额的 64.1%，同比增长 23.2%，主要得益于闪存、其他电源管理及 MCU 产品的需求增加。
- 本季度工业及汽车产品销售收入 1.379 亿美元，同比增长 11.3%，主要得益于 MCU 及其他电源管理产品的需求增加。
- 本季度通信类产品销售收入 7,980 万美元，同比增长 21.1%，主要得益于模拟及 RF 产品的需求增加。
- 本季度计算类产品销售收入 990 万美元，同比增长 78.3%，主要由于通用 MOSFET 及 MCU 产品的需求增加。

产能⁶及产能利用率

	二零二五年 第三季度 (未经审核)	二零二四年 第三季度 (未经审核)	二零二五年 第二季度 (未经审核)
总产能(折合 8 吋千片晶圆)	468	391	447
总体产能利用率	109.5%	105.3%	108.3%

- 本季度末月产能 468,000 片 8 吋等值晶圆。总体产能利用率为 109.5%，较上季度上升 1.2 个百分点。

付运晶圆

折合 8 吋千片晶圆	二零二五年 第三季度 (未经审核)	二零二四年 第三季度 (未经审核)	二零二五年 第二季度 (未经审核)	同比	环比
付运晶圆	1,400	1,200	1,305	16.7 %	7.3 %

- 本季度付运晶圆 1,400,000 片，同比上升 16.7%，环比上升 7.3%。

⁶ 期末月产能，且为比较目的，以 30 天作为计算基础。

经营开支分析

以千美元计	二零二五年 第三季度 (未经审核)	二零二四年 第三季度 (未经审核)	二零二五年 第二季度 (未经审核)	同比	环比
销售及分销费用	2,332	2,241	2,630	4.1 %	(11.3)%
管理费用 ⁷	98,101	79,189	95,287	23.9 %	3.0 %
经营开支	100,433	81,430	97,917	23.3 %	2.6 %

- 经营开支 1.004 亿美元，同比上升 23.3%，主要由于研发工程片开支及折旧开支上升；环比上升 2.6%。

其他收入净额

以千美元计	二零二五年 第三季度 (未经审核)	二零二四年 第三季度 (未经审核)	二零二五年 第二季度 (未经审核)	同比	环比
租金收入	3,625	3,612	3,460	0.4 %	4.8 %
利息收入	13,762	26,710	15,294	(48.5)%	(10.0)%
汇兑收入/(损失)	3,746	29,270	(1,064)	(87.2)%	(452.1)%
分占联营公司溢利	1,843	1,087	591	69.5 %	211.8 %
财务费用	(18,249)	(27,275)	(18,250)	(33.1)%	(0.0)%
政府补贴	12,741	18,535	9,866	(31.3)%	29.1 %
其他	284	(142)	705	(300.0)%	(59.7)%
其他收入净额	17,752	51,797	10,602	(65.7)%	67.4 %

- 其他收入净额 1,780 万美元，同比下降 65.7%，主要由于外币汇兑收益及利息收入下降，部分被财务费用下降所抵消；环比上升 67.4%，主要由于本季度为外币汇兑收益，上季度为外币汇兑损失。

⁷管理费用包括确认为研发开支抵减项目的政府补助。

现金使用分析

以千美元计	二零二五年 第三季度 (未经审核)	二零二四年 第三季度 (未经审核)	二零二五年 第二季度 (未经审核)	同比	环比
经营活动所得/(用)现金流量净额	184,150	(26,838)	169,630	(786.2)%	8.6 %
投资活动所用现金流量净额	(253,296)	(715,920)	(385,556)	(64.6)%	(34.3)%
融资活动所得/(用)现金流量净额	104,163	(5,007)	(25,185)	(2,180.3)%	(513.6)%
外汇汇率变动影响净额	22,816	90,648	8,076	(74.8)%	182.5 %
现金及现金等价物变动影响净额	57,833	(657,117)	(233,035)	(108.8)%	(124.8)%

- 本季度经营活动所得现金流量净额 1.842 亿美元，较上年同期经营活动所用现金流量 2,680 万美元，主要得益于客户收款增加。
- 投资活动所用现金流量净额 2.533 亿美元，其中包括固定资产投资支出 2.619 亿美元，及其他权益工具投资 1,400 万美元，部分被利息收入 1,560 万美元，及收到政府对设备的补助 700 万美元所抵消。
- 融资活动所得现金流量净额 1.042 亿美元，其中提取银行借款 9,990 万美元，员工行权发行股份收到 1,440 万美元，部分被支付利息 500 万美元，偿还银行借款 320 万美元及支付租赁负债 190 万美元所抵消。

资本结构

以千美元计	于九月三十日 二零二五年 (未经审核)	于六月三十日 二零二五年 (未经审核)
资产总额	12,511,666	12,237,080
负债总额	3,502,618	3,363,437
所有者权益总额	9,009,048	8,873,643
资产负债率 ⁸	28.0%	27.5%

资本开支

以千美元计	二零二五年 第三季度 (未经审核)	二零二五年 第二季度 (未经审核)
华虹 8 吋	19,305	17,612
华虹无锡	11,898	13,676
华虹制造	230,691	376,440
合计	261,894	407,728

- 本季度资本开支 2.619 亿美元，其中 2.307 亿美元用于华虹制造，1,930 万美元用于华虹 8 吋，及 1,190 万美元用于华虹无锡。

⁸资产负债率=负债总额/资产总额。

流动性分析

以千美元计	于九月三十日 二零二五年 (未经审核)	于六月三十日 二零二五年 (未经审核)
发展中物业	223,302	221,661
存货	526,840	513,434
贸易应收款项及应收票据	257,067	264,329
预付款项、其他应收款项及其他资产	494,222	452,513
应收关联方款项	22,150	14,360
已冻结存款及定期存款	31,993	31,756
现金及现金等价物	3,904,733	3,846,900
流动资产总额	5,460,307	5,344,953
贸易应付款项	275,064	263,352
其他应付款项及暂估费用	704,754	716,648
计息银行借款	340,686	341,313
租赁负债	3,598	5,839
政府补助	66,498	59,040
应付关联方款项	7,832	8,560
应付所得税	14,341	16,046
流动负债总额	1,412,773	1,410,798
净营运资金	4,047,534	3,934,155
速动比率	3.3x	3.3x
流动比率	3.9x	3.8x
贸易应收款项及应收票据周转天数	37	44
存货周转天数	85	88

- 存货由上季度末的 5.134 亿美元上升至本季度末的 5.268 亿美元，主要由于新工厂的在制品及产成品增加。
- 预付款项、其他应收款项及其他资产由上季度末的 4.525 亿美元上升至本季度末的 4.942 亿美元，主要由于增值税留抵税额增加。
- 贸易应付款项由上季度末的 2.634 亿美元上升至本季度末的 2.751 亿美元，主要由于采购额增加。
- 其他应付款项及暂估费用由上季度末的 7.166 亿美元下降至本季度末的 7.048 亿美元，主要由于本季度支付应付资本开支。
- 净营运资金 本季度末 40.475 亿美元，流动比率 3.9。
- 贸易应收款项及应收票据周转天数 37 天。
- 存货周转天数 85 天。

上述公布详情请参阅华虹半导体网站 www.huahonggrace.com。

华虹半导体有限公司
简明损益表(以千美元计,每股盈利和股数除外)

	截至以下日期止三个月		
	于九月三十日 二零二五年 (未经审核)	于九月三十日 二零二四年 (未经审核)	于六月三十日 二零二五年 (未经审核)
销售收入	635,180	526,306	566,065
销售成本	(549,326)	(462,299)	(504,454)
毛利	85,854	64,007	61,611
其他收入及收益	34,361	78,092	29,353
销售及分销费用	(2,332)	(2,241)	(2,630)
管理费用	(98,101)	(79,189)	(95,287)
其他费用	(203)	(107)	(1,092)
财务费用	(18,249)	(27,275)	(18,250)
分占联营公司溢利	1,843	1,087	591
税前溢利/(损失)	3,173	34,374	(25,704)
所得税开支	(10,363)	(11,461)	(7,097)
期内(损失)/溢利	(7,190)	22,913	(32,801)
以下各方应占：			
母公司拥有人	25,725	44,816	7,952
非控股权益	(32,915)	(21,903)	(40,753)
持有人应占每股盈利			
基本	0.015	0.026	0.005
摊薄	0.015	0.026	0.005
用于计算持有人应占每股基本盈利的 期内已发行普通股加权平均数	1,731,461,953	1,717,612,830	1,726,241,791
用于计算持有人应占每股摊薄盈利的 期内已发行普通股加权平均数	1,733,014,365	1,721,402,553	1,731,895,843

华虹半导体有限公司
简明综合财务状况表(以千美元计)

	截至		
	于九月三十日 二零二五年 (未经审核)	于六月三十日 二零二五年 (未经审核)	于九月三十日 二零二四年 (未经审核)
资产			
非流动资产			
物业、厂房及设备	6,162,217	6,101,971	5,198,989
投资物业	220,223	218,468	168,433
使用权资产	65,141	66,002	81,372
无形资产	33,982	27,313	38,897
于联营公司的投资	147,349	144,421	144,534
以公允价值计量且变动计入其他综合收益的权益工具	381,305	290,515	290,857
长期预付款项	41,142	42,672	83,396
递延税项资产	-	765	795
非流动资产总额	7,051,359	6,892,127	6,007,273
流动资产			
发展中物业	223,302	221,661	225,711
存货	526,840	513,434	487,480
贸易应收款项及应收票据	257,067	264,329	268,186
预付款项、其他应收款项及其他资产	494,222	452,513	269,191
应收关联方款项	22,150	14,360	25,426
已冻结存款及定期存款	31,993	31,756	32,443
现金及现金等价物	3,904,733	3,846,900	5,766,749
流动资产总额	5,460,307	5,344,953	7,075,186
流动负债			
贸易应付款项	275,064	263,352	273,352
其他应付款项及暂估费用	704,754	716,648	1,237,992
计息银行借款	340,686	341,313	262,296
租赁负债	3,598	5,839	4,451
政府补助	66,498	59,040	40,072
应付关联方款项	7,832	8,560	10,167
应付所得税	14,341	16,046	26,494
流动负债总额	1,412,773	1,410,798	1,854,824
流动资产净额	4,047,534	3,934,155	5,220,362
总资产减流动负债	11,098,893	10,826,282	11,227,635
非流动负债			
计息银行借款	2,056,802	1,933,971	1,983,494
租赁负债	15,329	15,035	19,334
递延税项负债	17,714	3,633	9,388
非流动负债总额	2,089,845	1,952,639	2,012,216
净资产	9,009,048	8,873,643	9,215,419
权益和负债权益			
股本	4,982,556	4,960,855	4,936,472
储备	1,466,529	1,339,047	1,478,303
本公司拥有人应占权益	6,449,085	6,299,902	6,414,775
非控股权益	2,559,963	2,573,741	2,800,644
权益总额	9,009,048	8,873,643	9,215,419

华虹半导体有限公司
简明综合现金流量表(以千美元计)

	截至以下日期止三个月		
	于九月三十日 二零二五年 (未经审核)	于九月三十日 二零二四年 (未经审核)	于六月三十日 二零二五年 (未经审核)
经营活动现金流量：			
税前溢利/(亏损)	3,173	34,374	(25,704)
折旧及摊销	187,269	143,557	179,658
应占联营公司溢利	(1,843)	(1,087)	(591)
营运资金的变动及其它	(4,449)	(203,682)	16,267
经营活动所得/(用)现金流量净额	184,150	(26,838)	169,630
投资活动现金流量：			
购买物业、厂房、设备及无形资产项目	(261,894)	(734,069)	(407,728)
投资其他权益工具	(14,030)	-	-
投资联营企业	-	-	(2,794)
其他投资活动所得现金流量	22,628	18,149	24,966
投资活动所用现金流量净额	(253,296)	(715,920)	(385,556)
融资活动现金流量：			
提取银行贷款	99,923	2,287	138,096
发行股份所得收益	14,376	1,471	2,218
偿还银行贷款	(3,284)	(4,476)	(125,677)
已付利息	(4,971)	(3,283)	(38,623)
支付租赁负债	(1,881)	(1,004)	(1,199)
支付股息	-	(2)	-
融资活动所得/(用)现金流量净额	104,163	(5,007)	(25,185)
现金及现金等价物增加/(减少)净额	35,017	(747,765)	(241,111)
期初现金及现金等价物	3,846,900	6,423,866	4,079,935
外汇汇率变动影响净额	22,816	90,648	8,076
期末现金及现金等价物	3,904,733	5,766,749	3,846,900

于本公告日期，本公司董事分别为：

执行董事

白鹏(董事长兼总裁)

非执行董事

叶峻

孙国栋

陈博

熊承艳

独立非执行董事

张祖同

王桂壖太平绅士

封松林

承董事会命

华虹半导体有限公司

白鹏

董事长兼执行董事

中国 香港

二零二五年十一月六日